



鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

H300-HR 专用系列

【导热硅胶垫片】规格书



-产品图-

应用特点：

- 低压力应用、可压缩性好
- 低热阻
- 良好的界面接触
- 良好的绝缘性、耐高压击穿

应用领域推荐：

- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 汽车电子
- 可穿戴设备

该系列产品符合RoHS、HSF、卤素管控标准。

储存条件：阴暗处储存

储存温度： $\leq 30^{\circ}\text{C}$

储存湿度： $\leq 70\%$

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

保质期：

在储存条件下：体积电阻率一年，其它性能为二年

不符合储存条件下：体积电阻率三个月，其它性能

六个月

产品性能

NO.	参数	单位	测试方法	
颜色	天蓝色	---	目视	
裁体	玻纤布	---	目视	
厚度	0.5~4	mm	ASTM D 374	
硬度*	25±5	Shore C	ASTM D 2240	
密度	2.95 ±0.2	g/cc	ASTM D 792	
拉伸强度*	≥0.1	Mpa	ASTM D 412	
延伸率*	≥100	%	ASTM D 412	
撕裂强度*	≥0.5	N/mm	ASTM D 624	
压缩保持力	20%	4.04	Psi	ASTM D 695
	30%	8.71	Psi	ASTM D 695
阻燃等级	V0	---	UL-94	
使用温度	-50~180	$^{\circ}\text{C}$	IEC 60068-2-14	

热学特性

导热系数	2.8±0.2	W/m·K	ASTM D 5470
热阻	≤ 1.5 (@15Psi/2mm)	$^{\circ}\text{Cin}^2/\text{W}$	ASTM D 5470

电学特性

击穿电压	≥5	KV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	≥ 10^{13}	$\Omega\cdot\text{cm}$	ASTM D 257
介电常数	≥5.5	@1MHz	ASTM D 150
介质损耗	≤0.1	@1MHz	ASTM D 150

*为不带载体测试数据，以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权

